

HC-839W

优越的导热性，粘接性

特征与优点:

- ◆粘接牢固，防潮减震绝缘。
- ◆导热性好。导热率为：1.2 W/m.K
- ◆可粘接大多数通用材料，无腐蚀性。

典型应用:

- ◆发热芯片与铝型散热片的粘接与固定。
- ◆电池组之间的导热粘接。
- ◆五金，玻璃、陶瓷的粘接
- ◆金属之间的散热粘接

白色 膏状 快干
导热系数1.2
导热 粘接 固定 减震



包装与储存:



100ml铝管；300ml, 2600ml塑胶管。

在环境温度 $\leq 25^{\circ}\text{C}$ ，RH $< 70\%$ 的储存条件下有6个月的在架寿命。

注:

- 1、本文所载是我公司认为可靠的资料，该产品说明中的数据都为非标准值。记载的内容，产品性能改良，产品规格等在没有预告的情况下可能会有所变更。
- 2、我公司只对产品是否符合规格给予保证，在使用时，一定要先进行测试，确认适合您使用目的产品。
- 3、我公司的硅酮制品是面向一般工业用途而开发。超过贮存期，经检验合格仍可使用。

HC-839W的主要性能

序号 (No.)	检验项目 (Items)	技术要求 (Technique Request)
1	反应类型	醇型
2	外观 (Exterior)	白色，粘稠膏状
3	表干时间 (Tack free time min)	3~10
4	完全固化时间 (hours)	8~24
5	比重 (Specific gravity)	1.5~1.6
6	硬度 (Hardness Shore A)	45~55
7	导热系数 (Thermal conductivity W/m.K)	1.2
8	伸长率 (Elongation %)	250~350
9	抗拉强度 (Tensile strength MPa)	≥ 2.5
10	粘接强度 (MPa)	≥ 2.0
11	体积电阻率 (Volume resistivity $\Omega\cdot\text{cm}$)	$\geq 2.2 \times 10^{14}$
12	介电强度 (kv/mm)	≥ 18
13	介电常数 (Dielectric constant 50Hz)	4.0
14	损耗因子 (50Hz)	0.002

使用方法及注意事项:

- 一、清洁表面：将被粘或被涂元器件表面清理干净，除去灰尘、油污等杂质；
- 二、施胶：按用量需求大小，剪开尖嘴端部，挤出即可，室温固化，不支持加热固化；
- 三、固化：此胶是吸收空气中水分从表面向内部固化，胶层最大固化厚度2~4mm，如超过4mm深度，最好是分两次涂；本产品表干时间3~10分钟，24小时后达到完全固化，冬天温度较低，固化时间也将延长。